

D I S C O

C O R P O R A T E R E P O R T

2 0 2 0



一級の企業活動を目指して

昨今、経済情勢や地球環境、科学技術など、企業を取り巻く状況は目まぐるしく変化しています。同時に、企業に求められる事業活動の内容や質、社会的な責任も日々変化しています。ディスコでは、このような状況にあっても目先の変化にとらわれず、進むべき方向性を明確にするため「DISCO VALUES」という企業理念を定めています。

DISCO VALUESには「企業活動すべてを一級のものとし、わたしたちの存在が社会・ステークホルダーから歓迎されるようになる」と明記されています。これには、国際的標準となるような技術・サービスを提供する企業として、社会の変化に柔軟に適応し、事業活動だけでなく、環境や社会に対する取り組みなども含めたあらゆる企業活動を、それにふさわしいレベルに高めていきたいという思いが込められています。

ディスコでは2003年より、PIM (Performance Innovation Management) と称する活動を導入しています。この活動では、まず部署や業務単位で定めた「あるべき姿」を基に目標値を設定し、短期間で振り返りをおこないます。その振り返りの中で、改善方法などに「自ら気づいていく」ことで、組織全体の進化がおこなわれることを目指しています。「一級の企業活動」を実現するためには、この活動により従業員一人一人が考え、気づきを得て、改善のために行動することが不可欠です。このPIM活動に継続的に取り組むことで業務の効率化が進み、あらゆる場面で進化が感じられる組織づくりが進んでいます。

また、2011年より個人Will会計という独自の管理会計を全社展開することで、個々の業務パフォーマンスを見える化し、仕事の採算管理に活用しています。この仕組みを通じて従業員は自らの意志によって仕事や働き方を選ぶことができ、やりがいを高めています。また、採算を取るための合理的な判断力が磨かれていくことで、従業員が自ら考えて意志決定ができるようになり、ディスコをこれまで以上に強い組織としています。

ディスコはこれからも妥協することなく、すべての企業活動を一級とすることを目指し、進化していきたいと考えています。今後ともご支援・ご協力のほど、よろしくお願い致します。

代表取締役社長

関家 一馬



DISCO VALUES

DISCO VALUESは、企業としての目指すべき方向性や経営の基本的なあり方、一人一人の働き方など、さまざまな観点から「あるべき姿」を明確にした企業理念です。DISCO VALUESには200を超える項目が明文化されており、実際の活動に反映できるよう体系的にまとめられています。その中には、企業の社会的使命を果たしつつ、さまざまなステークホルダーとの良好な関係の構築を目指す、という一般的なCSRの概念についても記載されています。ディスコは、経営的判断から日常業務まで、あらゆる活動がDISCO VALUESに沿っておこなわれることを目指しています。以下にDISCO VALUESの一例を紹介します。

高度なKiru・Kezuru・Migaku技術によって 遠い科学を身近な快適につなぐ

「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」は、ディスコのビジネステーマを指します。つまり、ディスコが展開する事業は「切る」「削る」「磨く」という3つの技術の領域から逸脱しないということを表しています。そのビジネステーマを通じて、日々進歩していく科学を人々の暮らしの豊かさや快適に帰結させていくことを、社会的使命(ミッション)としています。あえてローマ字で表記しているのは、それらの分野でディスコの技術が世界標準となり、日本語でそのまま通用するようなレベルを目指すという、強い思いが込められているからです。

Missionの実現性の向上および価値交換性の向上を 成長と定義する

企業の成長をどのように定義するかによって、企業経営は大きく変わります。ディスコでは、売上やシェア、規模の拡大などを「成長」とはしていません。ディスコにとっての「成長」とは、一つはディスコの社会的使命であるミッションの実現度が向上し、社会により大きな貢献ができるようになること。もう一つは、お客様・従業員・サプライヤー・株主などすべてのステークホルダーとの価値交換が充実し、お互いの満足度が高まることです。

Always the best, Always fun

「常にベストを尽くすことと、仕事を楽しむこと」をモットーにしています。お客様の期待に応えるために、仕事の質を徹底して追究することはプロとして当然のことです。しかしディスコはそれだけではなく、仕事そのものを楽しむことも奨励しています。これらは相反するものではなく、むしろ両立することでより充実した仕事につながるものと考えています。

Sonzai no Akashi
価値観の立脚点

Basic Ideals
企業としての目指すべき方向性

Management Ideals
経営の基本的なあり方

Management Guidelines
経営実務におけるあり方・考え方

Behavior Identity
従業員の行動指針

DISCO VALUESの体系

ディスコが提供する価値、ソリューション

ディスコが提供する加工ツール・装置が「切る」「削る」「磨く」ソリューションを生み出します。



ディスコの加工

ものづくりに不可欠な「切る」「削る」「磨く」の3種類の加工に特化しています。



ディスコの加工ツール

装置に取り付けて、加工するための砥石。



ディスコの装置

大きさや厚さを極めて細かくコントロールしながら、ものを加工する装置。

何を加工？

主にシリコン・サファイア・ガリウム砒素といった「半導体」や「電子部品」などの材料となる素材を加工しています。素材の種類は多岐にわたり、「シリコンウェーハ」「サファイアウェーハ」など「ウェーハ」と呼ばれる円盤状のものが大半を占めています。半導体や電子部品はスマートフォンをはじめ、パソコンやICカード、医療機器や自動車などの中で機能するものです。わたしたちの身近な製品にとって欠かせないものを、ディスコの技術で加工しています。

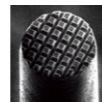
何のために加工？

スマートフォンやパソコンなどのデジタル製品を小さく、薄くするためには、その中で機能する部品を小さく、薄くする必要があります。その結果、同じスペースにたくさんの部品を搭載できるようになり、高機能にもなります。ディスコは、こういった「デジタル製品の進化」に貢献し、人々の生活の「快適」をつくり出しています。



どのように加工？

小さく切り分ける



μm (マイクロメートル、mmの1/1000)レベルで寸法の誤差を抑え、小さく切り分けることが可能です。それは、髪の毛の断面を30分割できるほどの精度です。

透けるほど薄く削る



5μmレベルまで薄く削ることができ（ちなみに、コピー用紙の厚さは約100μmです）。また、直径30cmのウェーハの厚さのばらつきを、1.5μm以内に収めることができます。

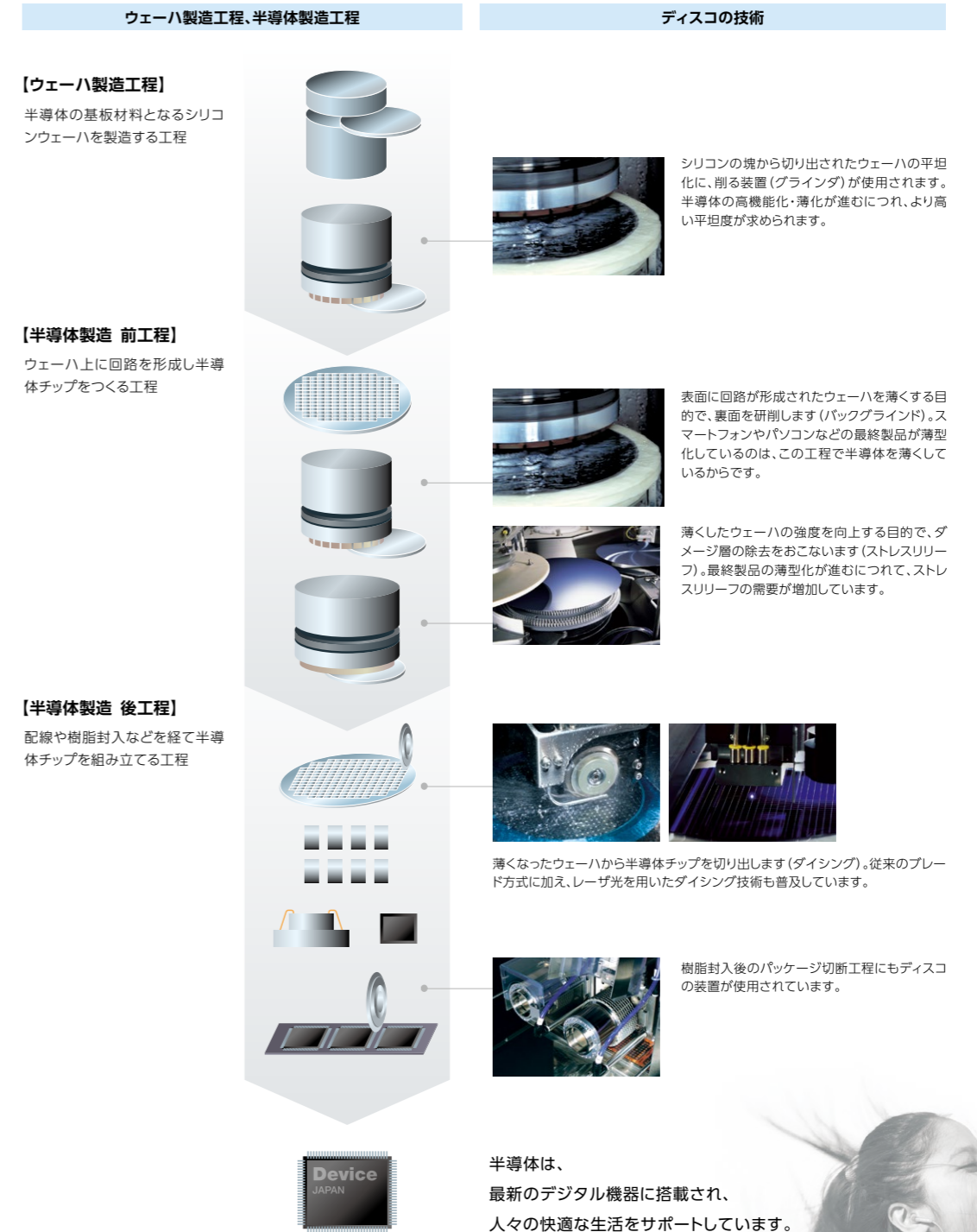
鏡のように磨く



顔が映るほどに磨き上げることで、素材の「割れにくさ」が大きく向上します。

半導体製造工程とディスコの技術の関わり

現在、ディスコ製品の大半が導入されている半導体製造工程では、機械・電気・物理・化学・情報処理など、多岐にわたる技術が活用され、付加価値の高い半導体がつくられていきます。

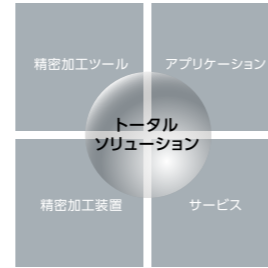


半導体は、最新のデジタル機器に搭載され、人々の快適な生活をサポートしています。



4つの事業分野、オンリーワンのトータルソリューション

ディスコの事業は4つの分野で成り立っています。
これらを有機的に融合することで生み出すトータルソリューションこそ、ディスコの最大の強みです。



精密加工ツール

1937年の創業以来培ってきた技術の粋

精密加工ツールとは、人造ダイヤモンドを用いた砥石に代表される製品です。装置に装着し、高速で回転させることで、素材の切断や研削をおこないます。切るための「ダイシングブレード」や、削るための「グラインディングホイール」、磨くための「ポリッシングホイール」などがあり、形状・厚さ・原材料・ダイヤモンドの大きさなど、加工要望に応じた選定が可能です。

ディスコはもともと砥石製造に立脚したメーカー。1937年の創業以来、お客様の課題を解決する具体的な手段として開発を続け、その種類は現在数万にも及びます。



アプリケーション

お客様が真に求める「商品」

「加工ツール」と「装置」、砥石の回転数や送り速度といった「加工条件」。これらの組み合わせは無限にあり、お客様自らが最良の製品選定をするのは容易ではありません。この課題を解決するのがアプリケーション技術。専任のエンジニアが、お客様にご提供いただく素材を加工検証(テストカット)することで、最良の加工結果に導く組み合わせを提案します。

ディスコでは、加工に関する課題の解決策、つまり「最良の加工結果」が商品であり、加工ツールや装置はそれを実現する手段と考えています。その考えを具現化する場として、本社・R&Dセンターに70を超える加工検証用ブースを設置しているほか、国内外の拠点にもアプリケーションラボを設け、無償でテストカットに対応しています。

精密加工装置

高度な「切る・削る・磨く」の実現、発想は無限大

精密加工装置は「切る・削る・磨く」加工をおこなう装置の総称です。ディスコではこれまで「ダイシングソー」や「グラインダ」など、砥石を装着して加工する装置を主に開発してきました。近年では、光で切る「レーザーソー」やダイヤモンドバイトで平坦化する「サーフェスプレーナ」など、加工手段の広がりも顕著です。

品質や生産性に加え、省スペース、低環境負荷など、お客様の装置への要望は千差万別。そういった要望に緻密に対応するために、大半の装置は標準仕様カスタマイズを加えた「セミオーダーメイド」となります。

ディスコはこれからも、高度な「切る・削る・磨く」技術領域で、人々の快適を創造する発想をカタチにしていきます。



サービス

ものづくりへの熱意は、サービスで結実

ディスコでは、製品納入後のサービスも重要な事業の柱と考えています。具体的には、装置の定期点検・修理などをおこなうアフターサービスと、オペレーション・メンテナンスのスキルを修得していただくための研修サービスが中心となります。アフターサービスを担当するカスタマーエンジニアには、6段階の社内資格制度を設け、世界中で同じ品質のサービスを提供できる仕組みを整えています。また、研修サービスでは、アンケートを通じていただく受講者の声を改善に生かし、満足を超えた「感動」を提供できるサービスを目指しています。

ディスコが加工ツールや装置など形あるものに寄せるものづくりへの熱意は、手に触れるような形のないサービスまで行き届いてこそ結実すると信じています。

快適を創造するディスコの「Kiru・Kezuru・Migaku製品」

ディスコは「高度なKiru・Kezuru・Migaku」を通じ、人々の暮らしを快適にしていきたいと考えています。その思いを実現するディスコの製品を紹介します。

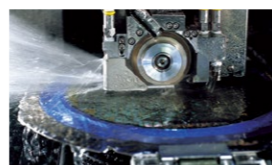


Kiru



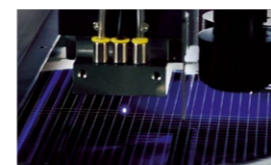
ダイシングソー

切断用砥石を取り付けて素材を切る装置。加工に特化したコンパクトな「マニュアルダイシングソー」と、搬送・洗浄機構を搭載した、生産性の高い「フルオートマチックダイシングソー」に大別されます。



ダイシングブレード

樹脂などの中に人造ダイヤモンドの粒を混合してつくる、切るための薄型砥石。



レーザーソー

レーザー光を用いて素材を切る装置。素材によっては、ダイシングソーより高速・高品質な「切る」を実現します。マニュアル・フルオート、双方のラインナップがあります。



ダイシングエンジン

半導体チップを外部からの衝撃、汚れや水の影響などから守るために樹脂で覆った「パッケージ」を切断するための装置。

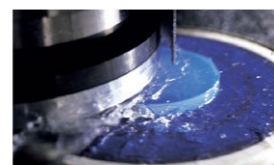


Kezuru



グラインダ

研削用砥石を取り付けて素材を削る装置。加工に特化した「マニュアルグラインダ」と搬送・洗浄機構を搭載した、生産性の高い「フルオートグラインダ」に大別されます。



グラインディングホイール

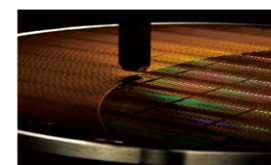
削るための砥石。ウェーハなどを薄く平坦にするための製品です。

Kezuru・Migaku



グラインダ・ポリッシャ

削る・磨くを一台で実現する装置。ドライポリッシュ・CMPなどポリッシュ手法の選択も可能です。



サーフェスプレーナ

ダイヤモンドバイトを用いて素材を平坦化する装置。金・銅などの延性材料や、LED用樹脂といった素材の表面を切削し、高精度に平坦化します。

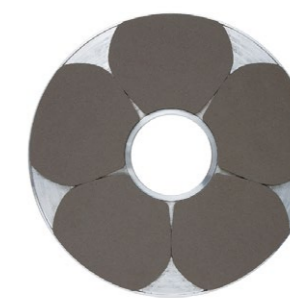


Migaku



ドライポリッシャ

素材を磨くための装置。加工に薬品や水を使用しないため、環境負荷を抑えられます。



ドライポリッシングホイール

ドライポリッシュ用研磨パッド。加工面を鏡面のように仕上げます。

未来の価値を創造するR&D

独創的なアイデアを積極的に活用し「未知のKiru・Kezuru・Migaku」の実現に挑戦し続けています。



東京に大規模な研究開発拠点

ディスコでは、本社機能と研究開発機能を兼ね備えた「本社・R&Dセンター」を東京都大田区大森に構えています。

羽田空港からも、新幹線が停車する品川駅からもアクセスしやすい大森の地を研究開発拠点に選んだ背景には、お客様との距離を短くして、頻繁に技術相談に来ていただきたいという思いがあります。お客様からの相談内容は、ディスコにとって次代の研究開発に向けた大きなヒントであり、貴重な財産となります。



「ひらめき」と「やってみること」を大切にする研究開発環境

本社・R&DセンターB棟は、フロアの大半が研究開発施設に充てられています。この棟では、エンジニアのデスクがある事務所スペースが、検証用の装置が並ぶスペースと隣接しています。エンジニアのひらめきを、実機を用いてすぐに検証できる環境を整えることで、変化の速い半導体業界においても、価値の高い独創的な技術や製品を提供し続けることができるのです。



お客様のニーズを新たな進化に

お客様が求めているのは、製品そのものではなく、それを使って得る「加工結果」であるという考え方をディスコでは大切にしています。お客様の求める加工結果の実現可否を、実際の加工を通じて検証(テストカット)するのが、本社・R&Dセンターをはじめ、国内外拠点に設けている「アプリケーションラボ」です。ラボでのテストカットは、お客様との信頼関係をより強固なものとすると同時に、加工結果を導き出すプロセス自体がディスコに高度なノウハウをもたらしてくれます。そのノウハウの蓄積こそが、さらに高度な相談に応える糧となっていくのです。





進化し続けるものづくり

創業当初から脈々と受け継がれるものづくり精神は製造プロセスの隅々まで行きわたり、常に進化を続けています。

お客様の満足を追求するものづくりの姿勢

ディスコは1937年、広島県呉市に「第一製砥所」という砥石メーカーとして創業しました。現在に至るまで、製品や技術は時代に応じたさまざまな変遷を経ていますが「お客様のニーズに応え、本質的な満足を提供し続ける」というものづくりに対する姿勢は、創業以来変わらずに持ち続けています。創業の地である呉市に2カ所、長野県茅野市に1カ所、合計3カ所にディスコの生産拠点があります。



セミオーダーメイドに応えるために

ディスコの装置には標準仕様が存在しますが、ほとんどのお客様は加工内容に合わせてカスタマイズを希望します。お客様からいただいた要求仕様を製品に着実に反映させるため、営業・技術・購買・製造・アプリケーションなど、複数の部署が綿密に連携を図ります。加工点に関わる特に重要な部品は社内製造比率を高め、より信頼性の高い製品を提供できるように日々努力しています。



進化活動でお客様の喜びを創造

国内外問わず全社的に展開しているPIM*活動を、製造現場でも積極的に推進しています。ブレード製造における不良発生率ゼロ活動や、装置製造における組み立て工数の削減など、製品の納期短縮や安定供給といったお客様の喜びに直結する成果を上げています。



*PIM: Performance Innovation Managementの略。

部署単位で「あるべき姿」を基に目標を定めて短期間で振り返り、目標と現状のギャップから、進化するための「気づき」を得る活動。張り紙や付箋紙を多用した目標と現状の「見える化」で、日常的に意識することを促す。

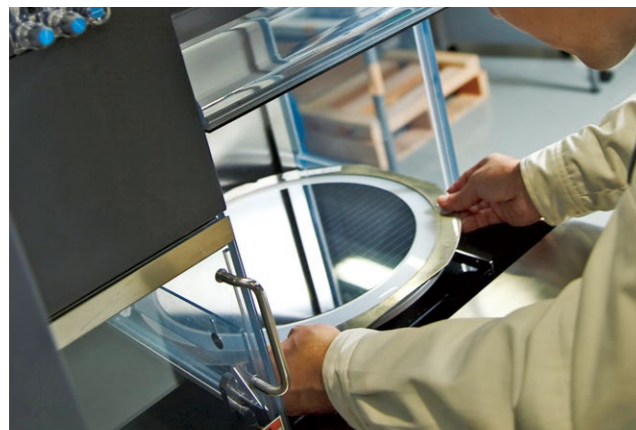
アプリケーションの徹底と追求。 すべては加工結果のために

■ ディスコのDNAとして受け継がれる、アプリケーション

ディスコにおけるアプリケーションとは、精密加工装置と精密加工ツール(砥石)を使いこなすための利用技術を指します。装置とツールを「使いこなす」とは、つまり自社製品の性能を最大限引き出し、加工結果が「最良である」と胸を張れる領域まで導くということです。最良を目指して加工する過程で得られる知見は蓄積され、未知の素材を加工する際の手がかりとなり、新しい課題の解決策にかたちを変えてお客様へ還元されていきます。

我々はお客様の本質的な満足につながるこのアプリケーションに、こだわりをもち続けてきました。そのこだわりは創業以来、加工対象が万年筆のペン先や積算電力計の部品など民生用から、半導体や電子部品素材などハイテク分野に移行しても、そして砥石だけだった加工手段にレーザーやプラズマが加わっても変わらない、ディスコの大きな強みとなっており、2012年度からは全社社員に対してその習得を必須としています。

このようにアプリケーションは、脈々と受け継がれてきた当社のDNAとも言える存在なのです。



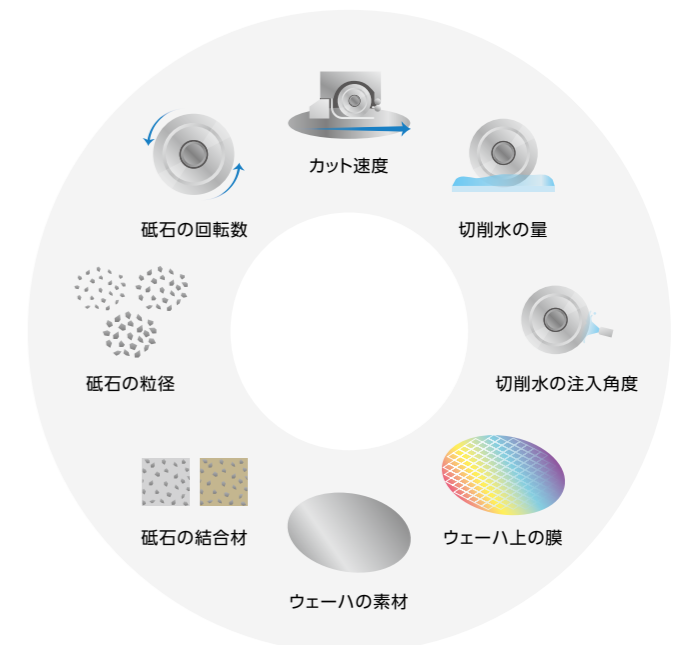
■ さまざまな要素から“最適”を導くテストカット

アプリケーションの追求は主に、お客様よりご提供いただくワーク(被加工物)のテストカット(加工検証)を通じて行われます。テストカットは、まず要求される生産性や設置スペース、予算等に応じた装置を選定し、ワークの材質や要求品質等を考慮しながら精密加工ツールを選定します。そして、加工ツールの回転数や加工テーブルの動作速度、冷却・加工屑除去のための切削水の量や温度、注入角度、ワーク固定の部材や方法など、多岐にわたる項目において、お客様の要望を満たすための加工条件を、テストを繰り返しながら見出していきます。

原則、テストを通じて最適と判断された条件が採用されますが、ワークの状態や累積加工枚数、装置の設置状況等、些細な環境の差が加工結果に影響することもあります。そのためテストカットは、当社製品の購入検討段階でももちろんのこと、新規デバイス開発時や、導入済製品の生産性・加工品質の向上をご希望の際など、さまざまなタイミングで実施されます。既存の製品では対応が難しい場合は、ツールや部品を試作して都度検証をおこないます。

さらに近年は、デバイス構造の複雑化やチップ積層のための極薄化等、加工に関する要望の高度化が進んでいることから、ブレードダイシング、レーザー加工、グライディングなど、複数手法をアプリケーションのノウハウを用いて組み合わせた加工プロセスの提案にも注力しています。

アプリケーションの構成イメージ(ダイシング)

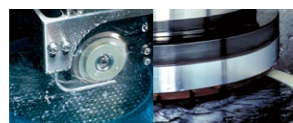


「ディスコなら何とかしてくれるだろう」というご期待に添えるよう、ワールドワイド約260名の専任エンジニアが、年間5000件を超えるテストカットに対応しています。

アプリケーションの粋を集めた、加工プロセス例

メモリ

DBG/SDBG



メモリ製造ではφ300mmウェーハの極薄化が求められています。DBGではウェーハ裏面を研削する過程でチップが分割され、原理的にウェーハ破損リスクを低減できることから、多くのお客様に採用されています。さらなるチップ強度向上のため、ステルスダイシングを併用したSDBGの採用も進んでいます。

メモリ

ダイセパレーション



ステルスダイシングにより改質層を形成した後のウェーハを、エキスパンドにより切断する装置がダイセパレーションです。ダイセパレーションではウェーハの切断の際、チップの接着に使用するDAF (Die Attach Film) の分割も同時におこなうことが可能です。

パワーデバイス

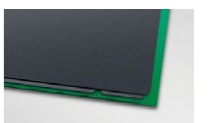
TAIKO



一部のパワーデバイスでは、薄化後のウェーハを、蒸着などの真空プロセスへ投入することがあります。TAIKO研削ではウェーハ外周を削らず、リング状に残すことで薄化後もウェーハの機械的強度が保たれるため、支持材を用いずに安全なハンドリングができるようになります。

パッケージ

パッケージダイシング



半導体パッケージの端子がリードフレームから樹脂基板に移行するなか、パッケージの個片化には金型プレス(トリム&フォーム)に代わり、ブレードダイシングが適用されるようになりました。モールド樹脂やエポキシガラス基板などの複合材を一度に切断でき、金型交換の手間もないことから、半導体パッケージの多品種少量生産に寄与しています。

メモリ

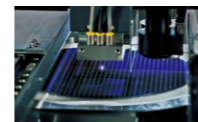
ストレスリリーフ DP/CMP/ドライエッチング



研削した薄ウェーハでは、微細なダメージを除去し、強度を向上させる必要があります。要求されているチップ強度やコスト等に応じた選択ができるよう、ドライポリッシュ、CMP、ドライエッチングなど、さまざまなストレスリリーフプロセスをラインナップしています。

ロジック

レーザーグルーピング



先端ロジックデバイスに用いられる低誘電率(Low-k)膜は機械的強度が低く、ブレードでの加工が困難です。非接触加工のレーザーグルーピングによりLow-k膜を先に除去することで、他のデバイス同様、ブレードダイシングを可能にします。

パワーデバイス

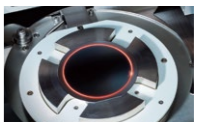
KABRA



従来のSiCウェーハ製造工程では、単結晶インゴットをスライスするために、主にワイヤソーを用いていました。ワイヤソーは、スライス加工の際に素材ロスが多く時間も掛かることから、コスト高の要因となっていました。KABRAはレーザーによりインゴットからウェーハを剥離するプロセスで、素材のロスを抑えて短時間でスライスすることができます。

LED

Laser Lift-Off (LLO)



高輝度LEDの製造プロセスでは、サファイア基板上に形成した発光層を剥離(リフトオフ)することがあります。従来、薬液やガスレーザーを剥離工程に用いる方式が一般的でしたが、ディスコのLLO装置は固体レーザーの採用によりコスト・メンテナンス工数を削減しながら、加工品質の安定化を実現しました。

お客様・サプライヤーとの価値交換性の向上を目指して

ディスコは、本質的なお客様満足 (Customer Satisfaction:CS) を追求し、お客様に感動と喜びを提供することを目指しています。また重要なパートナーとして、サプライヤーとの信頼関係を築くことにも注力しています。

CS向上活動

ディスコはCS憲章を掲げ、CS向上活動を積極的に展開できる企業文化づくりを推進しています。

CS向上には、お客様の真の期待に応えるための社内支援体制と、全従業員がお客様志向で行動する努力が必要です。

そのため、CS調査結果およびその結果を受けた活動内容や、装置の客先納品後に実施する「Short Interval Feedback」を通じて届くご意見などを、営業部門だけでなく間接部門にも共有し、さまざまな観点からCS向上活動の全社展開に努めています。

ディスコCS憲章

ディスコは、「高度なKiru, Kezuru, Migaku技術」を進化させ提供しつづけることで、お客様のパートナーとして信頼される企業を目指します。

- 私たちは常にお客様の声に耳を傾けます。
- 本質的なニーズにお応えする製品とサービスを一級の品質で提供します。
- 私たちは一人一人が常に誠実に行動します。
- 私たちは現状に満足することなく絶えず改善を行います。
- 私たちは感動と喜びを創造し、お客様から信頼され歓迎される存在を目指します。

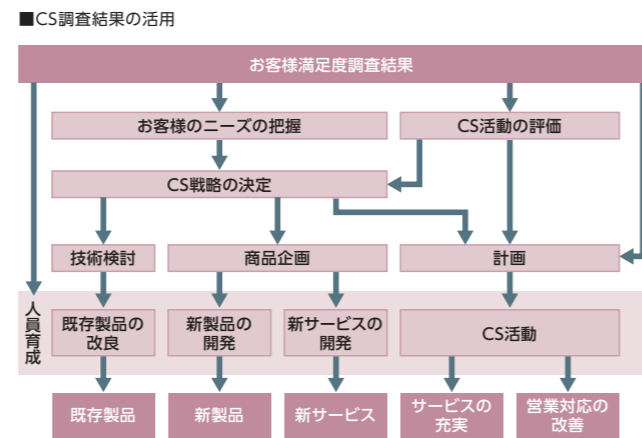
CS調査

当社のお客様からいただく苦言や提言も、お客様の期待により本質的に応えられる存在に進化するためのチャンスであると考えています。

1999年から継続しているアンケート形式のCS調査は、お客様の声を知るための重要な仕組みの一つに位置付けています。2014年以降は、従来の世界共通の一斉調査から、地域ごとのビジネススタイルに合わせた個別調査に変更し、各拠点が独自に進化させています。これにより、従来は埋もれてしまっていたようなニーズも、きめ細やかに拾い上げています。

調査結果は、新製品開発や既存製品の改良、新サービスの提供を検討する際の重要な情報となるほか、実行中のCS向上活動が計画通りに進捗しているかを検証するためにも使用します。検証結果は、営業・技術・サービス部門など関係部署へフィードバックし、より精度の高い活動にするために活用しています。また、内線とし

て利用しているiPhoneのアプリを通じて、従業員にお客様の声を届けることで、管理部門も含めたCS意識の向上を図っています。



Short Interval Feedback

ディスコの精密加工装置の大半は、お客様の望むさまざまな加工結果を実現するために、事前の検証結果をふまえた「セミナーメイド」の状態でご出荷されます。そのため、お客様の生産現場に納入された後に満足できる加工結果が実現できているかどうかを把握し、改善が必要な場合は迅速に対応する必要があります。このような装置の特性をふまえ当社では「Short Interval Feedback」という仕組みを導入しています。

Short Interval Feedbackでは納入した後に、使用状況や営業・代理店の対応などについてお伺いするシートをお客様に送付します。ご回答いただいたお客様の声は社内の関係者で共有し、必要に応じて営業・技術・サービス部門などが連携して対応しています。

お客様の一番の理解者になりたい

VOICE

日々デバイスを量産しているお客様は、とても多忙な中、テストカットや商談などに時間を割いていただいています。私の対応が遅れることで、お客様の量産スケジュールに大きな影響を与えてしまう可能性もあるので、とにかくスピード感を持って対応することが非常に重要だと考えています。そのためには、お客様のご要望、お問い合わせの本当の意図を早く、正確に把握できるよう、普段から密にコミュニケーションを取るよう心がけています。

そして、どんなに難しい課題でもお客様と共に解決策を模索し見つけ出すことで、お客様が一番の理解者になりたいと考えています。



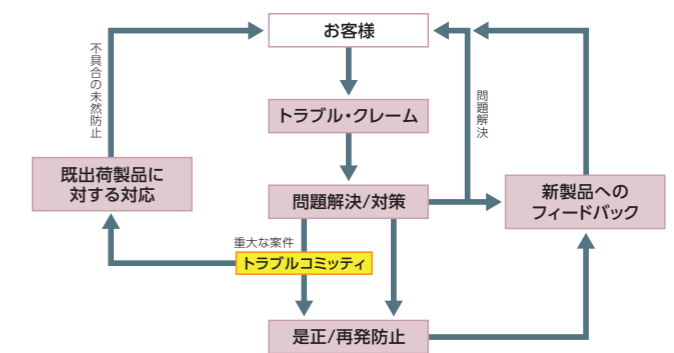
営業本部 国内営業部 林浩人さん

品質管理の徹底

お客様へ本質的な満足をお届けするためには、品質管理は欠かせません。ディスコでは品質方針を掲げ、その達成を確実にしていくために、品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001を認証取得しています。認証対象の組織は製品に携わる直接部門のみならず、これらの組織を支援する間接部門も含めています。海外現地法人も同様にISO9001を認証取得し、継続的な改善に努めています。

品質に問題が起きないように万全の体制を整えていますが、万一問題が発生した場合は、迅速に原因を調べ、解決する仕組みを構築しています。重大な案件については、社長と技術・営業など関連部門の部門長で構成された「トラブルコミッティ」を開催し、根本的な対策を検討しています。

品質問題対応の仕組み



輸出管理体制

お客様のもとへ製品を迅速にお届けするために、ディスコでは効率的な物流の実現に努めています。

例えば、税関への輸出申告は、外部の専門会社に委託するのが一般的ですが、当社は、AEO(Authorized Economic Operator) 制度における特定輸出者の承認を受けることで、自社施設での輸出通関手続きを可能としています。直接、航空会社へ製品を搬入することができるため、平時だけでなく災害発生時においてもリードタイムの短縮を実現しています。

また、2019年10月の台風19号の影響で関西国際空港便が欠航した際、北九州空港からの出荷に切り替えることで配送遅延を防ぎました。これまで、主に関空や神戸港を経由して出荷していましたが、北九州空港は九州地域唯一の24時間発着空港であり、アジア・東南アジア地域に向け迅速に配送できることから、2020年

1月より同空港の定期利用を開始し、災害発生時のリスク分散を図っています。



AEO輸出者承認マーク



北九州空港

サプライヤー満足度向上活動

サプライヤーの皆様は、ディスコにとって欠かすことのできないビジネスパートナーです。購買行動のあるべき姿を定めた「バイヤーの誓い」に、サプライヤーに接するすべての従業員が署名しています。

また、サプライヤーの皆様とより良いパートナーシップを築き上げるため、サプライヤー満足度調査を毎年実施しています。調査にて改善要望の多かった項目については、その原因を掘り下げて本質的な是正活動をおこなっています。

今後も本調査などを活用し、サプライヤーの皆様にとってもディスコが良きパートナーであるよう、努めていきます。

バイヤーの誓い

1. バイヤーは会社の顔です
2. サプライヤーは対等なパートナーです
3. 一切の贈答品は受け取りません
4. 接待は極力お断りします
5. 価格の妥当性を追求します
6. 透明で公正な業務遂行に努めます
7. サプライヤーに罷免されるような行動は取りません
8. どのような厳しい交渉の後でも、笑顔をもって和やかな雰囲気でお話しします

働きやすい職場環境へ

従業員一人一人が生き生きと働けるような施策実施や環境整備、そして成長の機会提供に努めています。

多様な人材への機会提供

ディスコは性別・年齢・国籍・人種・宗教・学歴などに関わらず「DISCO VALUES」に共感し、個性を生かして一緒にミッションを実現したいという方を積極的に採用しています。

例えば、定年後の働き方や生活を考える機会として、ライフプランセミナーを開催しています。60歳を過ぎても健康に問題がなく働き続ける意志がある人は、65歳までの再雇用制度を利用することができます。再雇用を希望しない場合でも、再

就職専門機関のカウンセリングや特別有給休暇の付与などを実施しています。

障がい者については、障害者就業生活支援センターや特別支援学校などから採用をおこなっています。外国籍の従業員の採用についても、ビジネスのさらなるグローバル化にともない積極的な採用を進め、国籍を問わず働きやすい環境づくりに努めています。

能力開発の支援

日々変化する社会において、企業はもちろん、従業員一人一人も変化への適応が求められています。また、個性や能力の発揮は自らの強い意思があってこそと考えます。ディスコはその意思を応援するため、各種教育などのプログラムを用意しています。近年は、全従業員を対象とした教育プログラム(DISCO Career Academy)や通信・通学講座のみならず、従業員が得意分野の講座を自発的に企画し、コミュニケーショントレーニングやプログラミング研修を実施したり、著名人を招いた講演会を開催するなど、スキルアップの機会が広がっています。

また、従業員同士の“関係の質”向上を推進するため、2015年度に福利厚生宿泊施設を部署単位で業務利用できる制度を開始しました。2019年度は、従来の長野・蓼科ロッジに加え、広島・ワラヒノロッジが利用可能となり、計987名が、ディスカッションや勉強会などで相互理解を深めました。



研修の様子

育児と仕事の両立支援

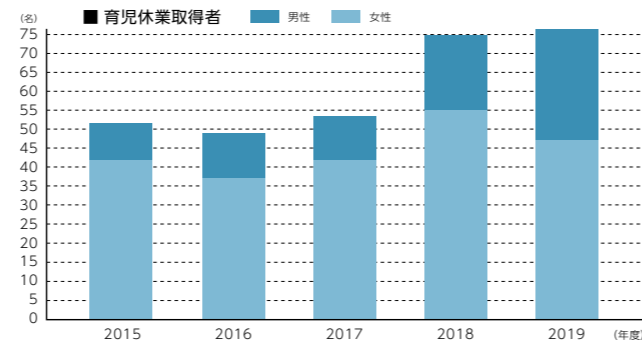
ディスコでは、従業員が仕事と生活を両立しながら能力を発揮できるよう、ワーク・ライフ・バランスの推進に努めています。その一環として「多様な価値観をもった従業員が仕事と育児を両立し、安心して働くことのできる環境づくり」をコンセプトに、2005年度から育児支援制度を導入し、制度や支援策を拡充しながら積極的な利用を促進しています。

この結果、2019年度は男女合わせて76名が育児休業を取得しました。

■ 育児支援制度の一部

- ・ 出産準備休業(産前休業前に取得可)
- ・ 育児サポート休暇
- ・ 子供が3歳になるまでの育児休業
- ・ 子供が小学校を卒業するまでの短時間勤務
- ・ 看護休業
- ・ 企業内託児所の設置
- ・ 看護が必要な間の在宅勤務

また、育児支援制度をより広義にとらえ、望んでいるにも関わらず子供に恵まれない従業員に対する、不妊治療費用の補助制度を2007年度から導入しています。年度内2回まで通算5年間、1回10万円を上限とする補助を実施しています。



男性育児休業取得者の声

VOICE

妻の「産後も仕事を続けたい」という思いをきっかけに、約9ヶ月間の育児休業を取得しました。職場から前向きに送り出してもらったお陰で、不安なく育児に集中することができ、子供の成長を間近で感じることができました。復帰時に参加した社内セミナーでは、復帰後の働き方のアドバイスを受けられただけでなく、同時期の復帰者との横のつながりもでき心強かったです。復帰後の職場では、業務分担の際、家庭との両立が可能かという点に常に配慮をしてもらっていると感じています。

また、ディスコ本社には事業所内保育所があるため、子供の預け先を心配する必要もありませんでした。寄り道することなく通勤できるため時間を有効に使うことができ、業務に集中できる環境が整っています。

今後より多くの男性社員に育児休業を取得して欲しいと思います。

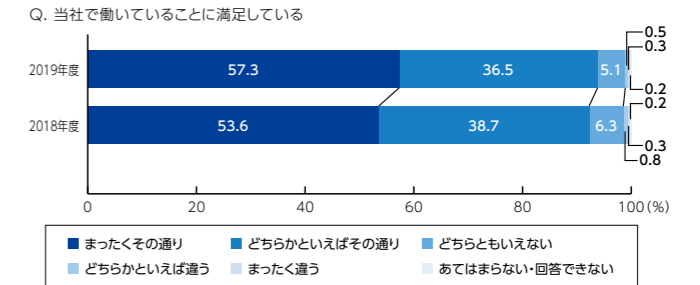


サポート本部

従業員満足度調査

従業員の声をより働きやすい職場環境づくりに反映させる目的で、2003年度から、無記名による従業員満足度調査を実施しています。調査結果は全従業員にフィードバックしています。2019年度は社員、準社員、パート、海外現地法人の社員約4,700名に対して実施しました。回答率は96.9%で総合満足度の肯定的な回答の割合は91.2%となりました。

■ 従業員満足度調査結果の一部



従業員の安全な職場作り

「すべての人が安心して働ける職場」とするために、当社は、施設・設備などのハード面はもとより、個人の行動や必要な情報の周知といったソフト面での災害対策にも力を入れています。

特に「安全衛生が企業文化として定着し、事故が起きない状態」を目指す「事故ゼロ」への取り組みに注力しています。入社時の安全教育をはじめ、KYT(危険予知トレーニング)、事故ゼロを実現するためのディスカッションなど、積極的に安全について考える機会を設けています。

このほかにも、安全で快適な職場環境を実現するための安全衛生委員会を、国内外の全拠点で毎月開催しています。委員は、各職場をパトロールして安全に優れた工夫や改善点を記録し、安全衛生委員会で報告しています。また、労災事故が発生した際は、該当部門

による事故対策の立案後、安全衛生委員会にてその対策の妥当性や水平展開について議論しています。事故の大小に関わらず全従業員へ事故内容の共有と対策実施を徹底しています。

さらに、2016年度より「社内運転免許制度」を導入しています。公的免許を取得している従業員であっても、業務上で運転が必要な場合には、社内運転免許の取得を必須としています。2019年度からは社内運転免許を更新制とし、毎年、独自の座学テストを実施することで、一人一人の安全意識の維持と運転行動の見直しにつなげています。



社内運転免許 運転テスト

従業員の健康への配慮

ディスコでは、従業員一人一人が健康の維持・増進に努め、明るく生き生きと過ごせるようにさまざまなプログラムや施設を用意しています。

ディスコは健康管理部門と健康保険組合が協力し、2013年度から「健康一級活動」を全社的に展開しています。2019年度は、自社開発した内線スマートフォン用アプリ「健康BINGO」を活用し、健康増進活動をおこないました。BMIの測定や月間歩数のカウント、食事写真の記録回数など、項目ごとの目標を達成することでBINGOのマスを埋めていき、そろった列に応じてインセンティブが付与される仕組みです。これにより、マスが埋まるたびにモチベーションを高めながら活動できました。

本社・R&Dセンターにはフィットネスジム・ヨガスタジオ・プール・マッサージコーナーなどを、広島事業所にはフットサル・テニスコート・プール・ヨガスタジオなどを設置しています。フィットネスジムでは個人に合わせたメニューをインストラクターに気軽に相談できる環境を整えており、ハード・ソフトの両面から従業員の健康増進をサポートしています。また、社内に医務室を設置し、従業員が社内で産業医や保健師からカウンセリングなどを受けられる体制を整えています。



内線スマートフォン用アプリ

TOPICS

「健康経営銘柄」に2年連続で選定

前年度に引き続き、経済産業省と東京証券取引所が共同で取り組む「健康経営銘柄」に選定されました。2019年度は「デンタル一級」をテーマに据え、全従業員が「デンタル不調がおよぼす健康へのリスク」について学んだ後に、歯科医による社内検診と歯磨き指導を受けました。さら

に、専用のスマホアプリを開発し、治療要否のお知らせや治療証明の登録、再検診の受診管理を容易にするなど、デンタルヘルスを身近に感じられる工夫をしながら活動をおこないました。



安心のためにできること

ディスコはどんなときであっても「安心して取引できる会社」「安心して働くことができる会社」であることを目指し、災害を“万が一”の出来事ではなく、“常に起こりうる”出来事として捉え、企業活動への影響を最小限に抑えるための体制づくりに継続して取り組んでいます。

災害に強い拠点づくり

日本は地震の多い国です。そのためディスコでは、本社・R&Dセンターや各生産拠点において免震構造を採用するなど、BCM (Business Continuity Management:事業継続管理) を強化しています。2015年1月、桑畑工場にて免震構造棟 (Bゾーン) の増築完了により、すべての精密加工ツール・精密加工装置を免震構造棟で生産できる体制が整いました。建屋には、停電時でも生産・出荷を継続できるよう、自家発電機及びその電力で稼働できる装置運搬用エレベータを設置しています。また、2019年1月にCゾーンを竣工し精密加工ツールの生産体制増強を図ったほか2021年8月にはDゾーンの竣工を予定しています。これにより、BCM対応力のより一層の強化が実現します。

精密加工ツールを生産する呉工場は瀬戸内海沿岸部に立地しているため、津波・高潮の被害を想定し、対策を講じています。万が一の浸水に備え、製造・製品出荷・検査工程を上層階に置き、工場外周には津波による被害を抑制する防潮堤・防潮板を設置しています。

また、2018年4月に長野事業所・茅野工場を開設し、既存棟での生産を開始しました。2020年12月には免震構造の新棟竣工を予定しており、茅野工場の規模は現状の約7.5倍に拡大します。現在は主要製品の大半を、広島県の呉工場と桑畑工場で生産しておりますが、新棟竣工により、生産体制と、災害に備えたリスク分散をこれまで以上に図ることが可能となります。



防潮板



茅野工場

災害に強い人づくり

ディスコはBCMの最大のポイントを「一人一人が自分の身を守る」と考え、自然災害や感染症などのリスクを想定し、従業員への啓発や身を守るための行動促進に努めています。

例えば、季節性インフルエンザや麻しん(はしか)といった感染症は、治療よりもまず感染しないことが重要です。また、パンデミックへの備えと啓発活動の一環として、感染予防、感染拡大防止対策を日々の対応のなかで強化しています。

■ リスク対策の一例

感染症対策の日常化	毎朝の体温登録と体調不良時の報告を義務づけることで、季節性インフルエンザや感染性胃腸炎などを社内に持ち込むことがないよう、毎日の健康管理を意識付けています。
色付きマスクの活用	インフルエンザなど感染症罹患後の復帰者および濃厚接触者、体調不良者には、社内でピンクのマスク着用を義務づけ、感染リスクの「見える化」をしています。
在宅勤務体制の構築	感染症の流行などにより公共交通機関での出社が困難になった場合を想定し、自宅からのリモート接続が可能となるシステムを構築、演習を実施しています。
帰宅困難者への支援体制	災害時に帰宅が困難になってしまった従業員のために、宿泊に必要な食料や物資などを社内に備蓄し、支援する体制を整えています。

TOPICS

「事業継続活動セミナー」を開催

地域の産業・社会にディスコらしく貢献したいという思いから、事業所周辺企業の皆様に向けた事業継続活動に関するセミナーを開催しています。初開催となった2019年度は東京、長野、熊本にて、計58の企業・団体に参加いただき、当社が培って

きたBCMのノウハウを、具体事例やワークショップを交えてお伝えしました。参加者からは、「BCP策定のヒントを得られた」「漠然とした不安が解消した」などの声をいただきました。



セミナーの様子

地域社会への貢献活動

社会の中の良き市民であることが「社会との関係づくり」の基本と考え、より良い関係づくりに努めています。

ホタルの生態系復活への取り組み

広島事業所桑畑工場では、地域の自然環境との調和を目指し、生物多様性の保全活動を継続しています。2019年度は、豊かな自然環境のシンボルと言えるホタルの生態系維持活動を、地域住民の皆様と呉市立郷原中学校の協力のもと実施しました。

2019年7月、地元で在来するホタルの幼虫を採取・保護し、工場内で育成を始めました。その育成の歩みを郷原中学校の文化学習発表会にて紹介し、2020年3月には桑畑工場内のビオトープへ試験放流しています。

今後も地域の皆様との関係を深めながら、初夏にホタルが舞う美しい工場となることを目指し、活動を継続していきます。



ホタルの幼虫採取の様子



郷原中学校での展示

海岸清掃の取り組み

台湾の現地法人DISCO HI-TEC TAIWAN CO., LTD. (DHT) では2018年度より海岸清掃活動を実施しています。これは、ダイビングを楽しむ社員の「ゴミだらけの海岸をキレイにしたい」という想いからスタートしたもので、2019年度にはDHTの社員とその家族計33名で活動しました。

参加メンバーが驚いたのは、海洋ゴミのほとんどがプラスチックであったこと、その量の多さでした。この経験から、エコバッグを積極的に使うことやプラスチック製ストローの使用をやめることなど、日常生活において“自分たちがすぐできる環境配慮”を意識して行動するようになりました。



海岸清掃活動の様子

広島・長野 プログラミングコンテストの実施

IoTやAI、自動運転など未来社会の実現には優秀なプログラマーが欠かせません。その発掘と支援を目的に、広島および長野事業所において自社運営でのプログラミングコンテストを2017年度より継続して開催しています。2019年度は両地区合わせて119名、16歳から66歳までの幅広い年齢の方々に参加いただき、上位入賞者には賞金を贈呈しました。さらなるスキルアップを応援することで、未来を創造する人材育成の一端を担っています。



TOPICS

企業版ふるさと納税活用による寄付・大臣表彰

「平成30年7月豪雨(西日本豪雨)」により、広島事業所の所在地である呉市は土砂崩れ、河川の氾濫による浸水、長期間にわたる断水など大きな被害を受けました。ディスコは市や周辺自治体と共同で、周辺地域の皆様に対し飲料水の配布・生活水の提供などの支援をおこなったほか、企業版ふるさと納税制度を活用した呉市への寄付を実施しました。本寄付は、企業による被災地貢献のモデルケースであると評価され、また、被災地域の復旧・復興

事業に同納税制度を活用した国内初の事例であったことから、2020年2月に内閣府特命担当大臣(地方創生担当)により大臣表彰を受けました。寄付金は、呉市による臨時フェリーの運航や臨時スクールバスの運行、被災された方々に対する借上げ住宅の提供や中古住宅取得への助成、観光施設の改修、復興イベントの開催といった事業に活用されました。



環境活動の展開

ディスコは、地球生態系と自然環境を守ることが重要であると認識し、循環型社会の一員として持続可能な事業を展開しています。

環境ビジョン

ディスコは、継続的な環境負荷低減活動に取り組む目的で、中長期計画である「環境ビジョン」を制定しています。2011年4月に制定した「環境ビジョン2020」は、環境の分野において2020年度末時点でのありたい姿を定めたものです。環境ビジョン2020の達成に向け、「CO₂削減」「省資源活動」「汚染予防」「生物多様性の保全」の4項目に取り組んでいます。

■ 環境ビジョン2020

2020年度までに、「環境一級企業」になっている

CO₂削減

・事業活動におけるCO₂排出量(売上高原単位)を、2020年度において2010年度比3.8%削減できている

省資源活動

・事業活動から、あらゆるMOTTAINAIが根絶できている
MOTTAINAIが根絶できているとは、事業活動で使用する水・電気・ガス・紙、廃棄物などをムダにせず使い切り、他部署などどこから見てもMOTTAINAIと言われない状態です

汚染予防

・環境事故ゼロが実現できている
・新たに法規制に追加される有害物質を先取りし速やかに対応できている

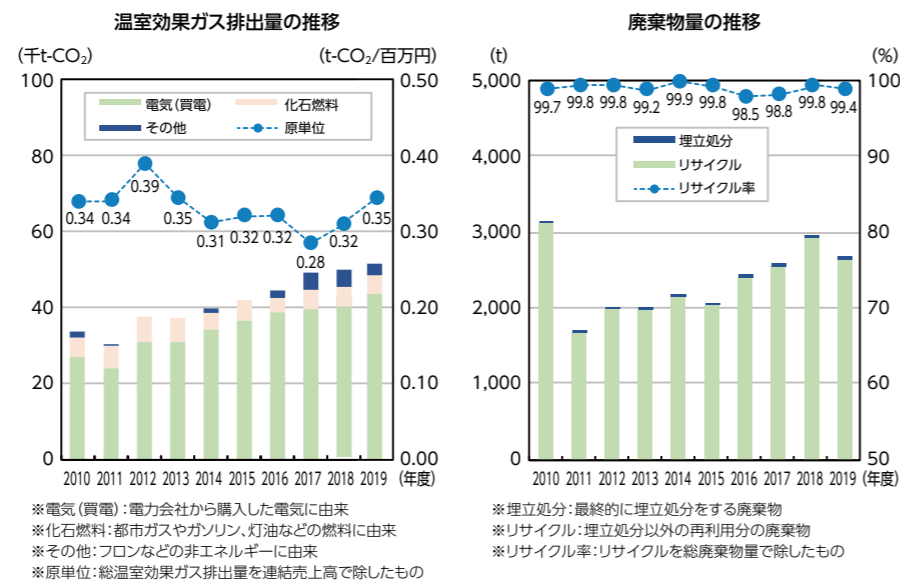
生物多様性の保全

・地域の自然保護活動に貢献できている

※社会情勢により各年度毎に適宜、活動目標を追加・変更します。

環境パフォーマンスデータ


ディスコでは「環境ビジョン」の一環として、「CO₂削減」や「省資源活動」に取り組んでいます。近年、生産量増加のほか、工場増築や人員増などに比例し、エネルギー消費(CO₂排出量)が増加しています。これを受け、2020年度からは、CO₂排出量削減に向けた取り組みを間接部門含めた全社で開始しています。また、近年増加傾向だった廃棄物量ですが、その減量に注力したことで、2019年度は減少に転じております。また、再資源化の促進により、99%以上の高いリサイクル率を維持しています。



TOPICS

第8回「みどりの社会貢献賞」受賞

「みどりの社会貢献賞」は、企業の緑化活動やその維持管理などに対し、社会・環境へ顕著な功績のあったものを公益財団法人都市緑化機構が表彰する制度です。広島事業所・桑畑工場は敷地内での継続的な緑化活動や、工場地元における里山保全活動を通じた社会貢献が評価され、受賞となりました。今後も生態系豊かな森林を次世代に引き継いでいくため、自治体と協力しながら、里山の保全活動を実施していきます。



広島事業所・桑畑工場

事業活動での環境配慮

ディスコでは、環境負荷を低減し、持続可能な事業を実現するためにさまざまな取り組みをおこなっています。

例えば、水資源の有効活用を目的として、本社・R&Dセンターと広島事業所へ、生産工程で生じる排水を再生・循環する装置を導入し、全社(支店や営業所も含む)の水使用量の約40%(2019年度 リサイクル率36%)をこの再生水で賄っています。精密加工ツールや装置の製造工程では多量の水を使用するため、費用面での効果だけでなく、地域における湧水対策にも貢献しています。

また、太陽光発電システムを積極的に導入し、発電した電力を事業活動に必要な電力として使用することで、温室効果ガスの削減にも貢献しています。(2019年度 発電量1,972MWh)

そのほか、作業工程の効率化や省資源を意識した生産活動などによって継続的な環境パフォーマンスの向上に取り組んでいます。



太陽光発電システム(桑畑工場)



排水リサイクル設備

■各拠点の太陽光発電能力

拠点	最大発電能力
本社・R&Dセンター	40 kW
桑畑工場	1,200 kW
呉工場	315 kW
茅野工場	140 kW
DISCO HI-TEC Singapore	75 kW
DISCO HI-TEC EUROPE	39 kW

環境配慮製品の展開

ディスコでは、地球環境や健康に有害な影響を与える化学物質の使用を回避するために制定した「グリーンプログラクトガイドライン」を軸に、各ライフサイクルでの環境負荷低減を考慮しながら製品の設計・開発をおこなっています。

精密加工装置

製品の原材料や部品購入時には、2003年度に定めた「ディスコ使用制限物質リスト」に基づき、RoHS指令で特定された6物質を含む15物質の有害化学物質を含有しないものを優先的に調達しています。

精密加工装置はRoHS指令の対象範囲外ですが、企業の社会的責任からグリーン調達を進め現在ではほぼすべての製品にて対応を完了しています。

精密加工ツール

製品の製造工程における化学物質管理体制の強化はもちろん、使用時における環境負荷低減にも力を入れています。

例えばウェーハ裏面のダメージを除去するストレスリリーフ工程では、ディスコは独自のドライポリッシングを採用しています。



DPEGシリーズ

乾式研磨であるドライポリッシングは、薬液を使用する手法に比べ環境負荷を低く抑えられます。

ドライポリッシングホイール「DP08シリーズ」「DPEGシリーズ」をラインナップし、エコフレンドリーな加工を推進しています。

周辺装置

ダイシングおよびグラインディング工程において使用される純水の製造・リサイクルをおこなう「DWRシリーズ」をラインアップしています。

イメージセンサや微細な配線ルールが採用されたデバイスなどにおけるダイシング工程では、切削屑の除去・洗浄時に高クリーン度が求められるため、純水の使用量が増加傾向にあります。DWRシリーズは、ダイシングソーからの切削廃水をほぼ100%循環再利用することが可能で、限りある水資源の有効活用を実現しています。



DWR1722

企業理念を軸とした組織経営

ディスコは、企業文化や価値観を絶えず共有し、継続的に良質化するための「組織経営」にも力を入れています。

企業理念の浸透活動

ディスコで働くすべての人が、企業理念である「DISCO VALUES」を理解し、日々の活動において実践・実現できるよう浸透活動を徹底しています。全役員・従業員が毎年必ず参加する階層別の研修から、部署単位での勉強会に至るまで、大小含めたさまざまな取り組みをおこなっています。

従業員一人一人が、DISCO VALUESの本質的な意味を理解するための議論やケーススタディなどに参加し、各々の業務に役立つ考え方を共有しています。このような浸透活動は、事業

を支える重要な経営基盤として約20年にわたって継続的に取り組み、組織力の強化につなげています。国内だけでなく、海外現地法人でもDISCO VALUESの共有活動が定着しています。



ディスカッションの様子

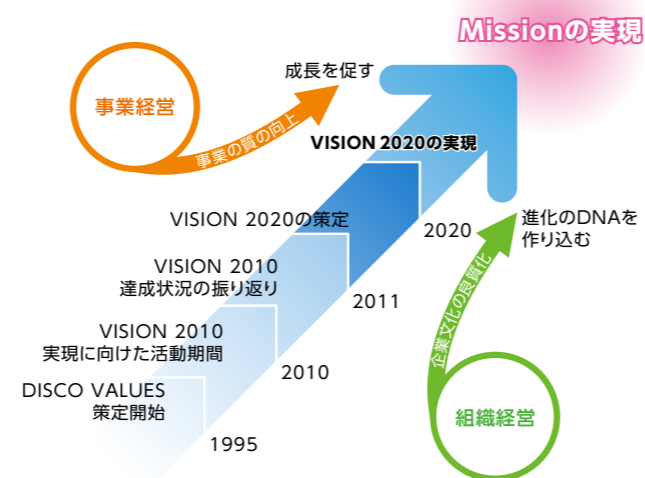
DISCO VISION

「DISCO VISION」は未来のディスコのありたい姿、目指すべき目標を具体的に明らかにし、Missionの実現を目指す上でのマイルストーンとしての役割を果たすものです。1997年に策定され、最初の達成年となる2010年に活動の振り返りを実施した後、さらに10年先をターゲットにした「DISCO VISION 2020」として進化しています。

DISCO VISION 2020は従来同様、売上高や利益などの定量的な要素に偏らず、定性的な要素も含めた内容になっています。また、事業や組織、人的資源といった「企業を構成する主要な要素：エレメントアングル」という観点に加え、「ディスコを取り巻くステークホルダーとの関係性：ステークホルダーアングル」という新たな観点を取り入れることで、ディスコの2020年の到達点をより立体的に定義しています。

活動の最終年となる2020年は、かつて到達点として掲げた高い理想を現実のものとしていくため、より一層進化活動を全社で加速していきます。

■ ディスコの経営構造



Will会計

2003年から独自の管理会計手法である「Will会計」を導入しています。「部門Will会計」として、Willという単位を用いて、社内業務による収入や人件費、設備費といった支出など、業務に関わるあらゆる事項に金額を設定し、部門の採算管理に活用しています。

さらに、2011年からは「個人Will会計」として、管理会計を従業員一人一人に落とし込んでいます。これにより、すべての仕事は従来型の指示・命令によって配分されるのではなく、上司や他

部門・他者から提示された、Willで値付けされた案件を、メンバーが自分の意志で選択して取り組む形へと変化していきました。この「個人Will会計」の展開が、動きがいやパフォーマンスの向上・意志決定のスピードアップを促し、ひいては生産性の向上につながっています。

今後もWill会計の活用により、組織経営の強化を進めてまいります。

PIM (Performance Innovation Management)

企業として組織力を高め進化していくためには、企業理念やビジョンに基づいた戦略の遂行だけでなく、遂行する能力を高めていくことも不可欠です。

ディスコでは2003年以降、PIMという業務改善活動を海外も含めた全社で日常的に推進することで、組織としての実行力・改善力を日々高めています。PIMは、業務を通じて得た気づきから改善案(メソッドチェンジ)を生み出し実行し、組織が進化し続けていくことを目的としています。

2012年からは対戦形式でメソッドチェンジの発表を実施しています。発案者同士が「PIMコロシウム」という専用スペースで、

限られた時間・資料を駆使して発表し合い、経営陣と従業員の投票によって勝敗を争っています。発案者は勝つための良質なメソッドチェンジを考えるアイデア力を鍛え、発表者はより多くの賛同を得るためのプレゼン力を磨きます。観客はWillを用いて投票するため、より真剣に観戦し、優れた改善案を見極める力も磨かれていきます。

PIM活動を継続することで、従業員は日々工夫を重ねていきます。それぞれの能力を磨いていくことで強い組織づくりが進み、企業としての進化につながっていきます。

コーポレートガバナンス

ディスコは監査役設置型ガバナンス形態を採用しており、役員の構成は社内取締役4名*に対し、独立社外役員6名(社外取締役2名*および社外監査役4名*)としています。

取締役会は、機動的な経営判断ができるよう少人数(社内および社外取締役6名)で構成し、議決権をもつ社外取締役により経営監督機能の実効性が確保されています。監査役会は、全員を社外監査役で構成し、監査の公平性や中立性を維持する体制を整えています。

このように積極的に社外の視点を導入することで、多角的な観点から妥当性の検証を行い、経営判断の透明性が向上することを目指しています。

さらに3名*の執行役員が経営層の一員として、経営執行の質を一層向上させる職責を担っています。また、社長が執行役員を統括・指揮し、取締役会および各取締役が、執行役員を監督する体制を取っています。

取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置しています。この委員会は、社長、社外取締役、社外監査役および取締役経験者で構成し、取締役・執行役員の各候補者の選解任案および報酬について審議・答申しています。また、監査役の各候補者の選解任案および報酬について監査役に助言しています。

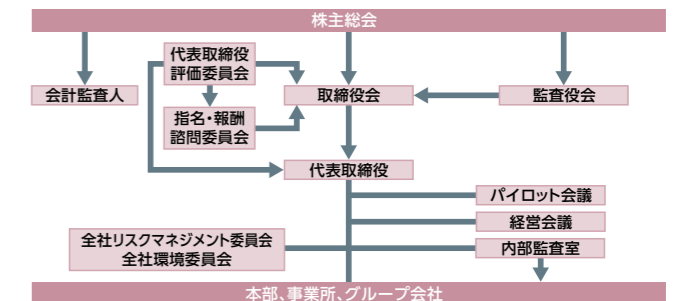
2018年度より、代表取締役の業務執行の適切性を評価する「代

表取締役評価委員会」を設置しました。この委員会は独立社外役員のみで構成されているため、評価結果により代表取締役を解任する際の客観性、公正性、透明性が確保できます。

また、「内部統制に関する基本方針」を定め、内部統制の整備と向上を図っています。内部統制の目的には、法律上の義務である「財務報告の信頼性確保」に加えて「法令の遵守や業務の有効性・効率性の向上」を掲げています。この実現を加速するため、内部統制を管轄する専任組織が中心となり、内部統制の概念・意義や評価ポイントなどの社内への浸透を推進するとともに、ディスコグループ全体に向けた内部統制の評価と構築支援をおこなっています。

※2020年5月末現在

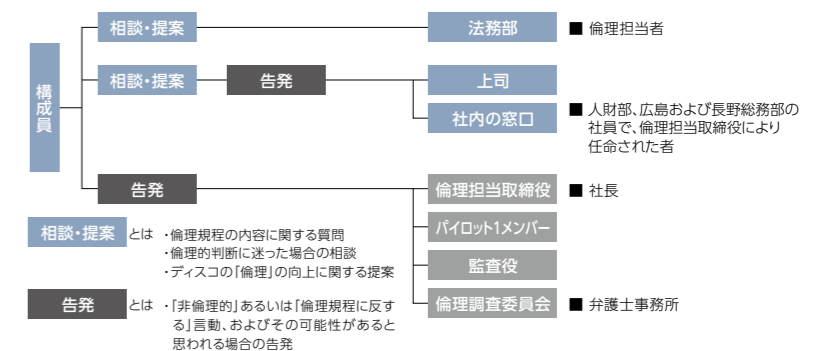
■ コーポレートガバナンス模式図

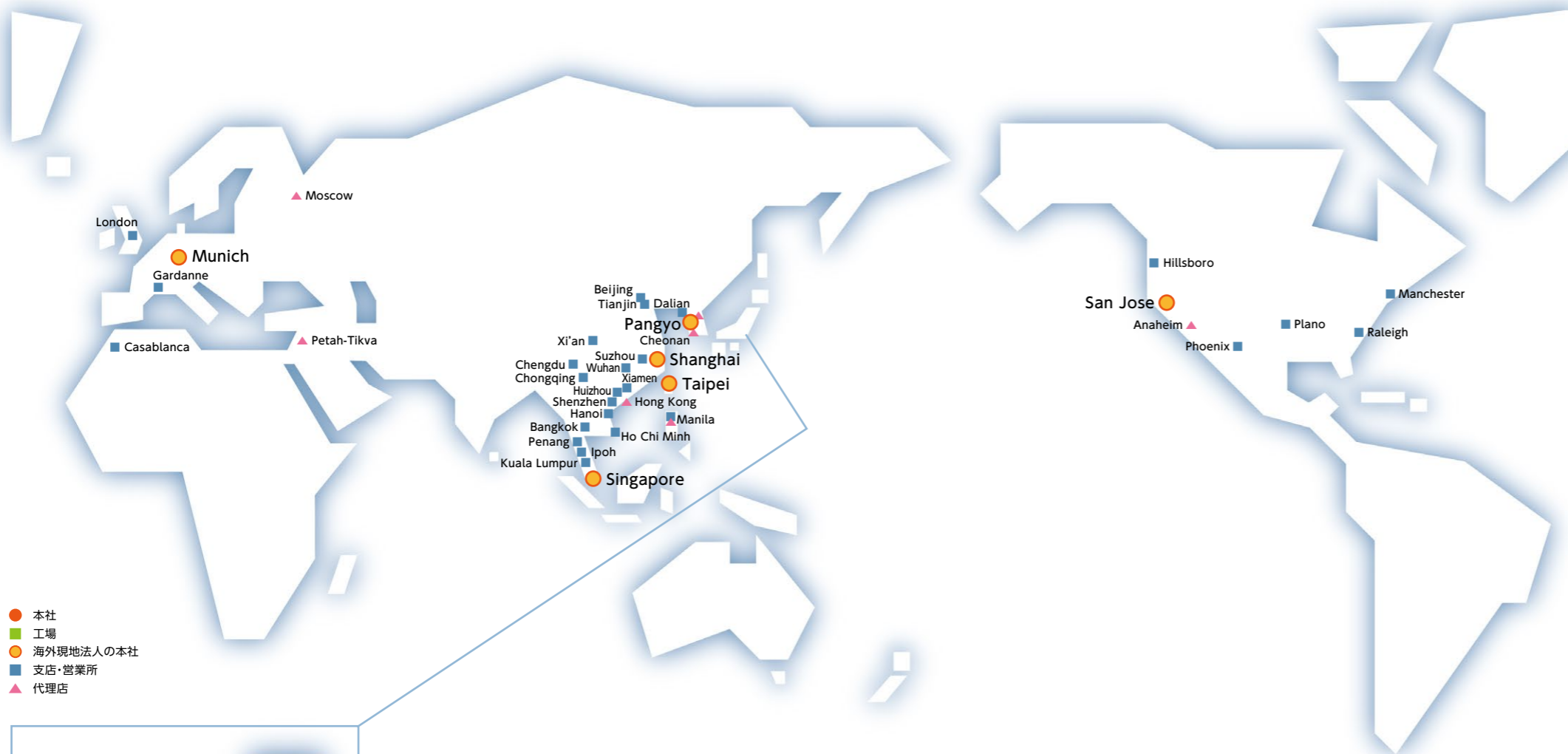


企業倫理

ディスコでは法令の遵守はもちろん、一般的に不道德とされることは絶対におこなわないという強い意志の下、倫理規程を策定しています。倫理的に「してはならないこと」を明文化したこの倫理規程は、解説とともに全従業員に配布されており、従業員は当社での活動や日々の言動において、これを遵守することが義務づけられています。また、従業員満足度調査においても倫理についての項目を設け、浸透度を定期的に確認しています。これらに加え、日々の業務で倫理的判断に迷った際の相談・告発窓口を設けています。

■ 倫理体制



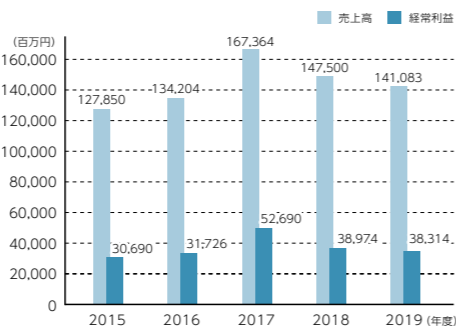


- 本社
- 工場
- 海外現地法人の本社
- 支店・営業所
- ▲ 代理店

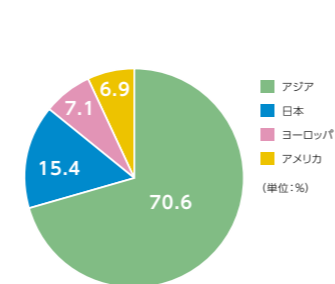


財務状況(連結)

■ 売上高・経常利益推移

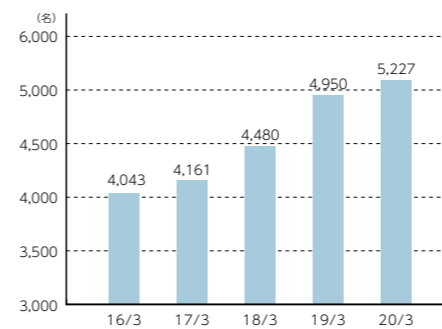


■ 地域別売上高構成比

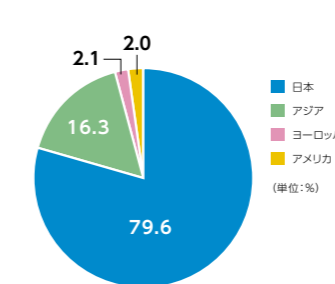


雇用状況(連結)

■ 従業員数推移



■ 地域別従業員構成比



会 社 の 商 号：株式会社 ディスコ
DISCO Corporation
本 社 所 在 地：〒143-8580
東京都大田区大森北2丁目13番11号
創 業 年 月 日：1937年5月5日
設 立 年 月 日：1940年3月2日
資 本 金：20,926,438,820円 (2020年5月末現在)
発行済株式総数：36,010,671株 (2020年5月末現在)
東京証券取引所 第一部上場
証券コード：6146

主な事業内容

1. 精密加工装置の製造および販売
2. 精密加工装置のメンテナンスサービス
3. 精密加工装置のオペレーションやメンテナンスの研修サービス
4. 精密加工装置の解体リサイクル事業
5. 精密加工装置のリースおよび中古品売買
6. 精密加工ツールの製造および販売
7. 精密部品の有償加工サービス

主な拠点・事業所

《アジア》

株式会社 ディスコ
株式会社 ダイイチコンポーネッツ
DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE LTD
DISCO HI-TEC (THAILAND) CO., LTD.
DISCO HI-TEC (MALAYSIA) SDN. BHD.
DISCO HI-TEC CHINA CO., LTD.
DISCO HI-TEC TAIWAN CO., LTD.
DISCO HI-TEC (VIETNAM) CO., LTD.
DISCO HI-TEC PHILIPPINES, INC.
DISCO HI-TEC KOREA Corporation

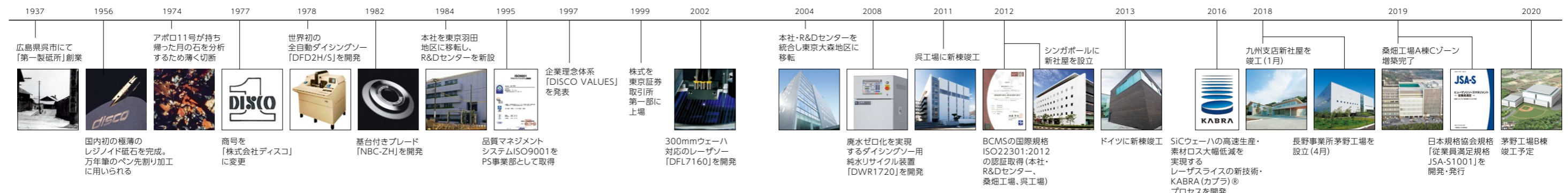
《北米》

DISCO HI-TEC AMERICA, INC.

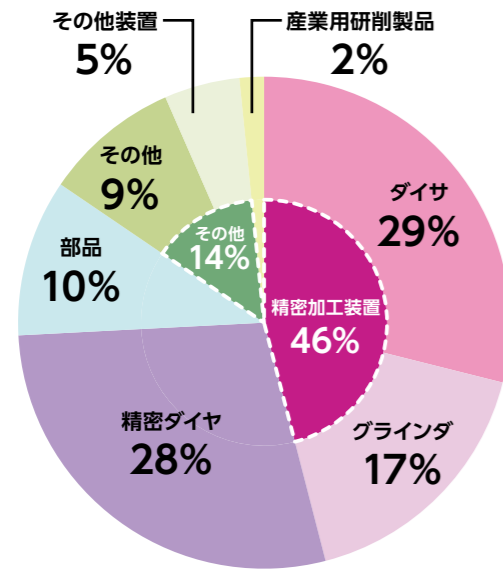
《欧州》

DISCO HI-TEC EUROPE GmbH
DISCO HI-TEC FRANCE SARL
DISCO HI-TEC U.K. LTD.
DISCO HI-TEC MOROCCO SARL

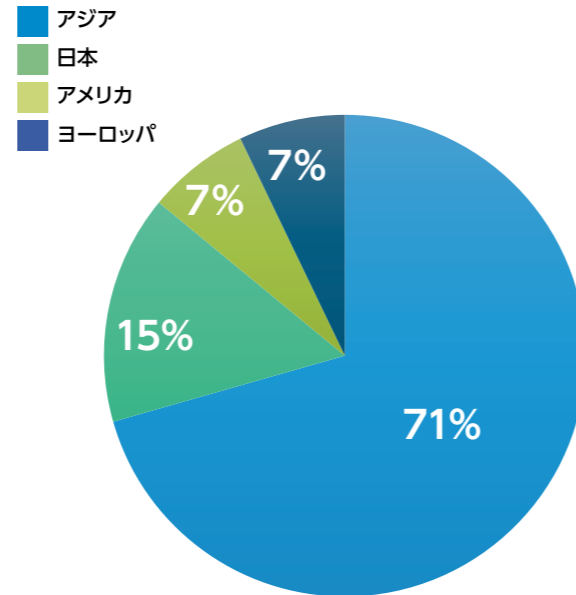
ディスコのあゆみ



■ 製品別売上構成



■ 地域別売上構成

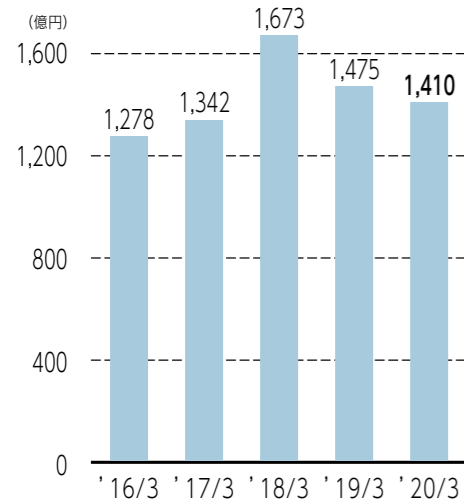


■ 要約

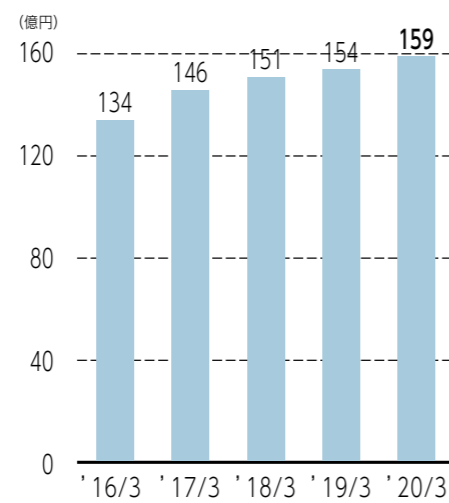
単位: 億円

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019
売上高	1,278	1,342	1,673	1,475	1,410
営業利益	303	313	509	386	364
経常利益	306	317	526	389	383
当期純利益	230	242	371	288	276
設備投資	85	114	120	153	259
減価償却	65	59	60	60	66
研究開発	134	146	151	154	159
総資産	2,079	2,257	2,563	2,581	2,743
負債合計	399	444	510	380	474
純資産	1,680	1,813	2,052	2,201	2,268
GP率	56.5%	55.5%	59.2%	58.9%	60.1%
営業利益率	23.7%	23.4%	30.5%	26.2%	25.8%
経常利益率	24.0%	23.6%	31.5%	26.4%	27.2%
純利益率	18.1%	18.0%	22.2%	19.5%	19.6%
4年累計経常利益率	19.1%	21.6%	25.5%	26.7%	27.4%
自己資本利益率 (ROE)	14.5%	13.9%	19.3%	13.6%	12.7%
自己資本比率	80.4%	79.9%	79.7%	84.8%	82.2%

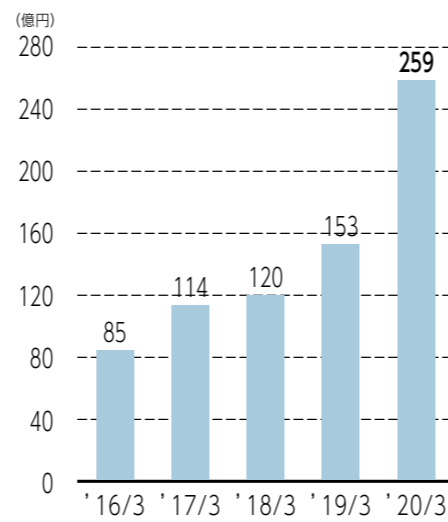
■ 売上高



■ 研究開発費



■ 設備投資



■ 連結貸借対照表

		単位：百万円	
		FY2018	FY2019
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	91,380	87,909	
受取手形及び売掛金	34,900	25,614	
商品及び製品	6,940	17,318	
仕掛品	12,585	14,373	
原材料及び貯蔵品	19,066	18,677	
その他	4,979	6,153	
貸倒引当金	△57	△56	
流動資産合計	169,795	169,990	
固定資産			
有形固定資産			
建物及び構築物(純額)	45,584	47,334	
機械装置及び運搬具(純額)	8,630	8,672	
工具、器具及び備品(純額)	787	755	
土地	14,610	14,855	
建設仮勘定	7,256	21,796	
有形固定資産合計	76,868	93,415	
無形固定資産			
投資その他の資産	400	319	
投資有価証券	2,875	2,107	
繰延税金資産	4,122	5,052	
退職給付に係る資産	821	910	
その他	3,314	2,546	
貸倒引当金	△17	△16	
投資その他の資産合計	11,116	10,599	
固定資産合計	88,384	104,334	
資産合計	258,180	274,325	
負債の部			
流動負債			
支払手形及び買掛金	3,368	5,726	
電子記録債務	13,178	10,301	
未払法人税等	1,782	3,509	
賞与引当金	7,790	9,861	
役員賞与引当金	177	131	
製品保証引当金	453	338	
資産除去債務	27	25	
その他	10,838	17,009	
流動負債合計	37,616	46,905	
固定負債			
資産除去債務	207	280	
その他	247	249	
固定負債合計	454	529	
負債合計	38,071	47,435	
純資産の部			
株主資本			
資本金	20,663	20,793	
資本剰余金	22,651	22,781	
利益剰余金	173,739	181,239	
自己株式	△25	△29	
株主資本合計	217,029	224,785	
その他の包括利益累計額			
その他有価証券評価差額金	476	368	
為替換算調整勘定	1,320	366	
退職給付に係る調整累計額	26	18	
その他の包括利益累計額合計	1,823	754	
新株予約権	1,108	1,212	
非支配株主持分	148	138	
純資産合計	220,109	226,890	
負債純資産合計	258,180	274,325	

■ 連結損益計算書

		単位：百万円	
		FY2018	FY2019
売上高			
売上原価	147,500	141,083	
売上総利益	60,589	56,290	
販売費及び一般管理費	86,910	84,792	
営業利益	48,264	48,341	
営業外収益	38,645	36,451	
受取利息		93	
持分法による投資利益	93	68	
為替差益	293	698	
受取賃貸料	-	833	
助成金収入	63	71	
その他	490	374	
営業外収益合計	215	226	
営業外費用	1,156	1,972	
売上割引		52	
為替差損	52	51	
減価償却費	751	-	
その他	9	46	
営業外費用合計	14	12	
経常利益	828	110	
特別利益	38,974	38,314	
固定資産売却益		19	
新株予約権戻入益	19	1	
受取保険金	2	0	
関係会社株式売却益	208	-	
特別利益合計	-	268	
特別損失	229	271	
固定資産除売却損		63	
減損損失	63	70	
投資有価証券評価損	58	-	
特別退職金	0	-	
災害による損失	88	51	
建物解体費用	533	-	
特別損失合計	202	186	
税金等調整前当期純利益	946	308	
法人税、住民税及び事業税	38,256	38,277	
法人税等調整額	9,355	7,656	
法人税等合計	36	2,916	
当期純利益	9,392	10,572	
非支配株主に帰属する当期純利益	28,864	27,704	
親会社株主に帰属する当期純利益	40	50	
	28,824	27,653	

■ 連結キャッシュ・フロー計算書

		単位：百万円	
		FY2018	FY2019
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益	27,311	31,299	
減価償却費	38,256	38,277	
売上債権の増減額(△は増加)	6,095	6,612	
たな卸資産の増減額(△は増加)	8,695	△5,202	
仕入債務の増減額(△は減少)	△3,744	△33	
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△3,785	△466	
その他営業活動によるキャッシュ・フロー	△17,204	△5,425	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,001	△2,461	
有形固定資産の取得による支出	△14,513	△25,660	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,436	△24,868	
配当金の支払額	△12,982	△10,580	
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△13,001	△10,741	
現金及び現金同等物の期首残高	△193	△5,568	
現金及び現金同等物の期末残高	85,545	85,351	
	85,351	79,782	

CSR情報は2019年度(2019年4月1日~2020年3月31日)を対象にしています。



株式会社 **ディスコ**

お問い合わせ先

広報室

143-8580 東京都大田区大森北 2-13-11

Tel:03-4590-1090 Fax:03-4590-1076

www.disco.co.jp